

適正や欠陥の有無を診断できる解析手順

様々な環境試験に耐え、十分な信頼性を有していることを明示するため電氣的に良品であるデバイスの内部構造を詳細に観察し、微細な内存欠陥や不具合構造も検知できる診断が可能です。

1 試料の受入確認

本格的な分析までに 試料の状態を測定顕微鏡、光学顕微鏡などを使い クラック、パッケージ状態、損傷、リードの変色の細部を確認します。
輸送中の不具合もここで確認します。

2 電気特性検査

デジタルマルチメーターを用いて電氣的な破壊の有無を調べます。

3 非破壊検査

SEM-EDX： 表面状態（異物付着）を確認
はんだ接合、クラック、ワイヤーの形状観察
元素分析

SAT： 微細な内存欠損（剥離、空隙）
チップの接着剤の濡れ性を確認

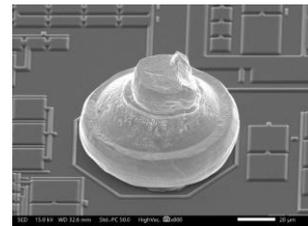
4 破壊検査

電気特性検査や非破壊検査で異常が認められた場合
断面研磨やケミカル開封を実施する事で、より詳しく表面からは見えない内部的な欠損を観察することができます。

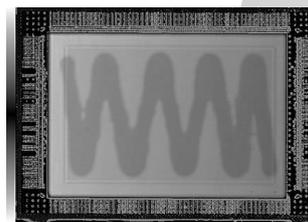
5 その他

必要と判断すれば、気になる部分の寸法測定や元素分析を行える装置もございます。

■ 実例：SEM画像
 bumpsの観察



■ 実例：SAT画像
チップの接着剤の濡れ性観察



ご相談およびご依頼の内容は、機密厳守を第一に細心の注意を払っています。特にご要望の場合は秘密保持契約をさせていただきます。